



■「プライベートショー2011」のご案内

2011. 10. 7

日酸TANAKAでは、下記要領で「プライベートショー2011」を開催致します。
「技術の日酸TANAKA」から、t 32mmの軟鋼切断を行うファイバーレーザや、高性能
プラズマ切断機の新製品など自信作が勢揃い致しました。多数のご来場をお待ち申し上げます。

○日時

平成23年11月10日(木)～12日(土) 10:00～16:00

○場所

日酸TANAKA株式会社 本社・埼玉工場

埼玉県入間郡三芳町竹間沢11 東武東上線「みずほ台」駅より車で約10分

○主な出展品(実演も予定しています)

①ファイバーレーザ切断機 FMR30-T5000

新製品 軟鋼32mmの切断

②LMRV30-TF6000【i-マーキング装置】

省エネ機能、i-マーキング装置搭載、新機能・小円切断機能

③LMXVII Z30-TF6000開先レーザ切断機

新機能・省エネSUS切断を搭載

④KT-790PJXプラズマ切断機【ペガサス500プラズマ搭載】

新製品 省エネ、裏開先40度、R面取りなど各種切断機能

⑤KT-650PGRプラズマ+ガス切断機

新製品 低価格ラインナップ

⑥ロボットガス切断機(水素切断仕様)

高生産性、高品質の水素切断を用いたロボットガス切断機

このほか、制御機器製品、溶接機材商品、ガス供給機器製品なども出展しています



切断 溶接 ガス制御のトータルソリューション

日酸TANAKA株式会社	本社	〒354-8585	埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢11
	新橋	〒105-0003	東京都港区西新橋1-16-7大陽日酸新橋ビル5F
	FA営業部(国内)	049 (258) 4412	
	制御機器事業部	03 (3500) 0951	
	溶接機材事業部	03 (3500) 0940	
	ガス事業部	03 (3500) 0960	

<http://www.nissantanaka.com/>